

Mate 2010

16th Symposium on
Microjoining and Assembly Technology in Electronics
2 - 3 February 2010, Yokohama

第 16 回

「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

日 時 : 平成 22 年 2 月 2 日(火) , 3 日(水)

場 所 : ワークピア横浜 (<http://www.workpia.or.jp/>)
横浜市中区山下町 24-1

主催 : (社)溶接学会 マイクロ接合研究委員会

共催 : (社)高温学会 微細加工研究情報委員会

(社)日本機械学会 高密度エレクトロニクス実装における信頼性設計と熱制御に関する研究分科会

(社)日本塑性加工学会 接合・複合分科会

(社)日本電気制御機器工業会

エレクトロニクス生産科学学会準備会

レーザ加工学会

大阪大学 先端科学イノベーションセンター

協賛 : 映像情報メディア学会 , エレクトロニクス実装学会 , 応用物理学会 , 化学工学会 , 画像電子学会 , 軽金属学会 , 計測自動制御学会 , 高温学会 , 高分子学会 , 資源・素材学会 , システム制御情報学会 , 情報処理学会 , 精密工学会 , 電気化学会 , 電気学会 , 電気設備学会 , 電子情報通信学会 , 日本機械学会 , 日本金属学会 , 日本顕微鏡学会 , 日本材料学会 , 日本シミュレーション学会 , 日本接着学会 , 日本セラミックス協会 , 日本塑性加工学会 , 日本顕微鏡学会 , 日本伝熱学会 , 日本非破壊検査協会 , 日本表面科学学会 , 日本品質管理学会 , 日本複合材料学会 , 日本物理学会 , 日本分析化学会 , 日本溶接協会 , 表面技術協会 , プラスチック成形加工学会

問合せ , 申込先

〒 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-11
(社)溶接学会 Mate 2010 事務局

Mate 2010 担当連絡先

TEL:03-3253-0488 FAX:03-3253-3059

E-mail: s_kogure@tt.rim.or.jp

シンポジウムURL <http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2010.html>

開催主旨

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムでは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

参加費：主催・共催団体加入会社：20,000円
協賛学協会会員会社：30,000円
論文口頭発表者：15,000円
大学・国公立研究機関：10,000円
学生：5,000円
その他：40,000円

トピックス

カテゴリー A 工 法	カテゴリー B 研究・開発の観点	カテゴリー C 対象形態・製品
A- 1 マイクロ接合 A- 2 マイクロソルダリング A- 3 ナノプロセッシング A- 4 薄膜形成 A- 5 厚膜形成（めっきなど） A- 6 ビーム加工 A- 7 エッチング A- 8 マイクロ加工 A- 9 塑性加工 A-10 接着 A-11 光・電子アセンブリ A-12 光インターコネクション A-13 その他	B- 1 プロセス B- 2 材料 B- 3 機能特性 B- 4 メカニズム B- 5 拡散現象 B- 6 界面構造 B- 7 信頼性 B- 8 品質 B- 9 解析・シミュレーション B-10 設計・システム B-11 設備・機器 B-12 検査・評価 B-13 生産管理・マネジメント B-14 計測 B-15 環境調和・リサイクル B-16 生産戦略・企画事業化 B-17 その他	C- 1 パッケージ（IC・LSI） C- 2 モジュール（SiP・SOC, etc） C- 3 パワーデバイス C- 4 エネルギー変換素子 C- 5 エネルギー変換機器 C- 6 通信機器 C- 7 携帯機器 C- 8 コンピュータ・周辺機器 C- 9 ディスプレイ C-10 カーエレクトロニクス C-11 医療・バイオ製品・機器 C-12 MEMS C-13 航空宇宙・車両 C-14 回路・部品内蔵基板 C-15 その他

組織委員会

委員長：日置 進（NPO E-TECH）
副委員長：竹本 正（大阪大学）
委員：渥美 幸一郎（東芝モバイルディスプレイ㈱） 荒木 孝雄（愛媛大学） 生田 幸士（名古屋大学）
石田 清仁（東北大学） 岩見 基弘 恩澤 忠男
亀原 伸男（富士通クオリティ・ラボ㈱） 越川 孝範（大阪電気通信大学） 小林 紘二郎（(財)若狭湾エネルギー研究センター）
齋藤 重正（富士電機機器制御㈱） 座古 勝（大阪大学） 佐藤 武彦（大阪大学）
佐藤 了平（大阪大学） 嶋田 勇三（㈱日本電気特許技術情報センター） 菅沼 克昭（大阪大学）
隅田 敏（㈱東芝） 田井 英男 高井 治（名古屋大学）
高島 一寿（㈱日立製作所） 高橋 康夫（大阪大学） 成田 敏夫（北海道大学）
貫井 孝（シャープ㈱） 藤原 憲之（パナソニック㈱） 盆子原 学（㈱ザイキューブ）
町田 一道（中京大学） 松村 慶一（ジー・エス・イー㈱） 三宅 正司（近畿大学）
南 三吉（大阪大学） 宮崎 則幸（京都大学） 宮本 勇（大阪大学）
森安 雅治（三菱電機㈱） 山本 治彦（富士通エレクトロニクス㈱） 渡部 武弘（千葉大学）

実行委員会

委員長：藤本 公三（大阪大学）
副委員長：加柴 良裕（三菱電機㈱）
委員：赤松 俊也（㈱富士通研究所） 秋山 哲也（九州工業大学） 朝倉 義裕（神戸市立工業高等専門学校）
新井 進（信州大学） 池田 順治 池田 徹（京都大学）
石塚 直美（日本電気㈱） 出田 吾朗（三菱電機㈱） 一山 靖友（㈱日鐵テクノリサーチ）
伊藤 元剛（㈱東レリサーチセンター） 岩田 剛治（大阪大学） 植木 義貴（エスベック㈱）
上西 啓介（大阪大学） 岩田 強（横浜国立大学） 裏 升吾（京都工芸繊維大学）
大熊 秀雄（㈱エイ・ティ・オー） 大口 達也（日本アビオニクス㈱） 大貫 仁（茨城大学）
大村 悦二（大阪大学） 大森 弘治（パナソニック㈱） 小川 倉一（(財)大阪産業振興機構）
折井 靖光（日本アイ・ビー・エム㈱） 片山 直樹（北海道立工業試験場） 加藤 力弥（千住金属工業㈱）
鎌田 信雄（㈱村田製作所） 荻谷 義治（芝浦工業大学） 菅野 敏之（㈱松村石油研究所）
気賀 智也（ソニーEMCS㈱） 日下 正広（兵庫県立大学） 久保 雅男（パナソニック電器）
栗秋 博幸（パナソニック溶接システム㈱） 栗原 孝（新光電気工業㈱） 河野 英一（㈱河野エムイー研究所）
後藤 友彰（富士電機ドバノステック㈱） 小山 真司（群馬大学） 今野 武志（(独)物質・材料研究機構）
斎藤 誠一（㈱ADEKA） 阪元 智朗（オムロン㈱） 作山 誠樹（㈱富士通研究所）
酒見 省二（パナソニックエレクトロニクス㈱） 三治 真佐樹（㈱デンソー） 柴崎 正訓（タムラ化㈱）
柴 敏哉（大阪大学） 莊司 郁夫（群馬大学） 莊司 孝志（昭和電工㈱）
角谷 透（㈱船井電機新応用技術研究所） 節原 裕一（大阪大学） 芹沢 弘二（㈱日立製作所）
千田 英博（㈱ニコン） 高尾 尚史（㈱豊田中央研究所） 高須 誠一（キャノンマシナリ㈱）
高橋 邦夫（東京工業大学） 武井 信二（富士電機ドバノステック㈱） 武井 利泰（日本精工㈱）
敏宏（大阪大学） 津久井 勤（リサーチラボ・ツクイ） 富村 壽夫（熊本大学）
西浦 正孝（パナソニックエレクトロニクス㈱） 西川 英信（パナソニック㈱） 西川 宏（大阪大学）
三宮 隆二（三井金属鉱業㈱） 原賀 康介（三菱電機㈱） 廣瀬 明夫（大阪大学）
二本 信次（大阪大学） 前田 将克（大阪大学） 松坂 壮太（千葉大学）
松嶋 道也（大阪大学） 三谷 進（ニホンハン㈱） 南 浩尚（住友金属鉱業㈱）
宮崎 誠（長野沖電機㈱） 三輪 洋介（㈱神戸製鋼所） 森 郁夫（㈱東芝）
森 敏彦（名古屋大学） 安田 清和（名古屋大学） 山口 敦史（パナソニック㈱）
山下 志郎（㈱日立製作所） 山根 常幸（㈱東レリサーチセンター） 山部 光治（㈱東芝）
渡辺 聡（藤倉化成㈱） 渡辺 裕之（イビデン㈱） 渡邊 裕彦（富士電機ドバノステック㈱）

（一部依頼中を含む）

E-mail: s_kogure@tt.rim.or.jp